



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten



Call for Papers
Elektronische
Baugruppen und
Leiterplatten
EBL 2026

**Sicherung der europäischen
Wertschöpfungsketten**

13. DVS/GMM-Tagung

24. – 25. Februar 2026
Schwabenlandhalle Fellbach

www.ebl-fellbach.de

ZIELSETZUNG DER TAGUNG

EBL 2026

Sicherung der europäischen Wertschöpfungsketten

Die „Negativ-Nachrichten“ überschlagen sich Tag für Tag, und das Gefühl, dass irgendwie alles aus dem Lot geraten ist, drängt sich förmlich auf. Politische Instabilitäten und eine weltweit schwächernde Wirtschaft machen sich insbesondere in unseren Leitindustrien bemerkbar, zu denen die Elektrotechnikbranche ohne Frage zählt. Dieser Zustand ist das Ergebnis einer Vielzahl von Versäumnissen, welche Politik und Wirtschaft gemeinsam zu verantworten haben.

Wie anfällig die Lieferketten sind und wie empfindlich die globalisierte Wirtschaft auf Ausfälle reagiert, hat die jüngere Vergangenheit gezeigt. Mit dem European Chips Act wurden erste Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen, um die Souveränität auf einem wichtigen technologischen Gebiet zu stärken. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die Chip-technologie zwar ein wichtiger Schlüssel, aber bei weitem nicht das einzige kritische Element in der Wertschöpfungskette ist. Elektronische Systeme erfordern die Beherrschung der gesamten Baugruppentechnologie, die vor allem aus Kostengründen zunehmend nach Asien verlagert wurde.

Dabei geht es nicht nur um einzelne Komponenten, sondern um ganze Technologien – einschließlich der Fähigkeit, diese industriell und wettbewerbsfähig herzustellen. Auch wenn es vermutlich keinen „European PCB Act“ oder ähnliche Initiativen für andere wichtige Technologien geben wird, bleibt deren Beherrschung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie entscheidend. Dabei muss die Baugruppentechnologie mit der stetigen Entwicklung der Chip-technologie schrifthalten können, sodass der innovative Vorsprung europäischer Entwickler und Hersteller von wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung ist.

Die Leiterplatten- und Baugruppentechnologie muss weiterentwickelt werden, damit die Chip-technologie zum Tragen kommen kann. Sie ist die technologische Plattform für das Embedding elektronischer Komponenten, die Hochfrequenztechnik, die Leistungselektronik und die Digitalisierung sowie für Anwendungen der Photonik bis hin zum Quantencomputing. Dafür benötigen wir eine resiliente Lieferkette innerhalb der europäischen Region, die ebenfalls einen hohen Grad an vertikaler Integration aufweist.

Diesen Themen widmet sich auch die Tagung EBL 2026 und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Informationsaustausch, zur Vernetzung und zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit – insbesondere für die europäischen KMU.

Wir freuen uns auf zahlreiche Vortragseinreichungen.

Bernd Enser
Vorsitzender der
Programmkommission

Prof. Dr. Mathias Nowottnick
Wissenschaftlicher Tagungsleiter

EINREICHUNG VON BEITRÄGEN

Bitte erstellen Sie ein ca. 200 Wörter umfassendes Abstract mit vollständigen Kontaktdaten der Autoren und Angabe mindestens eines der „Themen der Tagung“. Die Abstracts werden in einem elektronischen Tool gesammelt, das Sie unter

www.ebl-fellbach.de

finden.

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- Die Arbeit ist neu und wurde an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht.
- Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit müssen klar beschrieben sein.

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde und erhalten dann eine Schreibanleitung für ihr Manuskript. Mit der Annahme des Beitrags wird anschließend ein „full paper“ mit einer Länge von sechs Seiten erwartet. Bitte verwenden Sie dazu die Rubrik Einreichung von Beiträgen auf der Website der Veranstaltung.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Die Teilnehmer der Tagung erhalten vor Tagungsbeginn einen zitierfähigen Tagungsband.

TERMINES

Deadline für Abstracts	28. Juli 2025
Autorenbenachrichtigung	29. August 2025
Abgabe der Papers	01. Dezember 2025

THEMEN DER TAGUNG

- Digitalisierung, Machine Learning, KI
- Intelligente Systemkonzepte, Designtools, Tests und Simulation
- Neue Materialien
- Energieeffizienz, Thermisches Management
- Funktions- und Schaltungsträger
- Modul- und Baugruppenfertigung
- AVT, Weichlöten, Kleben, Sintern, Bonden, Lasern
- Prozesssimulation und -steuerung
- Traceability, Compliance, Produkt- und Prozesssicherheit, Technische Sauberkeit
- Testmethoden, Zuverlässigkeit und Analytik
- Trends, Nachhaltigkeit, Additive Fertigung
- Integrierte Funktionen und Schaltungsträger, Embedded Components, Advanced Packaging

APPLIKATIONEN

- Mobilität, Transportation
- Harsh Environment
- Industrielektronik, -automation
- Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung
- Leistungselektronik
- Messtechnik
- Medizintechnik
- Sicherheitstechnik
- Smart Home und IoT
- Datentechnik
- Digitale Kommunikation
- Hochfrequenztechnik
- Photoniksysteme
- Sensorik

EBL-PREIS FÜR DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS

Zusammen mit der GMM bietet der DVS mit der EBL als wichtigster deutschsprachiger Konferenz auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik in der elektronischen Baugruppenfertigung ein Forum für Experten aus Industrie und Forschung. Belohnt wird der beste Beitrag mit einem „Nachwuchs-Preis“. Anlässlich der EBL 2026 werden wir deshalb wieder eine eigene Nachwuchs-Session mit anschließender Verleihung einer Urkunde und einem Preisgeld anbieten.

PROGRAMMKOMMISSION

Vorsitzender der Programmkommission

B. Enser, Sielaff GmbH & Co. KG

Wissenschaftlicher Tagungsleiter

M. Nowotnick, Universität Rostock

Mitglieder

M. Eisenbarth, ZF Automotive Germany GmbH, Alfdorf
R. Fiehler, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf
A. Fix, Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen
J. Franke, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
S. Fritzsche, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau
U. Grimmer-Herklotz, Felder GmbH, Oberhausen
S. Härter, Siemens AG, Erlangen
M. Hauer, Dyconex AG, Bassersdorf, Schweiz
A. Hensel, Siemens AG, Erlangen
T. Huesgen, Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
J. Nicolics, Technische Universität Wien, Österreich
M. Oppermann, Technische Universität Dresden
U. Pape, Volkswagen AG, Wolfsburg
T. Rapala-Virtanen, EIPC, Pernö, Finnland
L. Rauscher, DVS – Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V., Düsseldorf
M. Reichenberger, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
A. Reinhardt, SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim
T. Scharf, Infineon Technologies AG, Regensburg
H. Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe
M. Schleicher, SEMIKRON International GmbH, Nürnberg
R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Offenbach am Main
M. Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM, Berlin
D. Schucht, Lackwerke Peters GmbH & Co. KG, Rot am See
H. Schweigart, Zestron Europe GmbH, Ingolstadt
R. Seidel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
S. Tank, DVS Media GmbH, Düsseldorf
N. Thielen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
J. Thüsing, Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Balve
J. Trodler, Trodler EAVT, Königs Wusterhausen
S. Uredat, VDE/VDI Innovation + Technik GmbH, Berlin
C. Weiß, ZVEI e.V., Frankfurt am Main
P. Wild, RehmThermal Systems GmbH, Blaubeuren
K. Wilke, Siemens AG, Berlin
J. Wolf, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Niedernhall
A. Zimmermann, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Stuttgart

TAGUNGSORGANISATION EBL 2026

DVS Media GmbH

Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf

Ansprechpartnerin: Sabrina Tank

P: +49 (0)211 / 1591-141
M: +49 (0)173 / 6534-243
E-Mail: sabrina.tank@dvs-media.info oder
tagungen@dvs-media.info

PARTNER



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.



AUSSTELLER UND SPONSOR WERDEN AUF DER EBL 2026

Möglichkeiten hierzu finden Sie unter: www.ebl-fellbach.de

TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird Firmen und Instituten die Möglichkeit gegeben, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in einer Tabletop-Ausstellung zu präsentieren. Bitte sprechen Sie uns an und reservieren Sie Ihre Ausstellungsfläche rechtzeitig!